



## 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年2月6日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社

上場取引所 東

コード番号 6590 URL <https://www.shibaura.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 今村 圭吾

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営管理本部長 (氏名) 今井 晋二 TEL 045-897-2425

配当支払開始予定日 -

決算補足説明資料作成の有無：有（当社ウェブサイトに決算説明資料を掲載予定です。）

決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2025年3月期第3四半期の連結業績（2024年4月1日～2024年12月31日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	56,554	18.1	9,296	14.7	9,180	14.8	6,948	14.8
2024年3月期第3四半期	47,899	5.4	8,104	△2.5	7,999	2.8	6,050	△1.4

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 6,971百万円 (9.5%) 2024年3月期第3四半期 6,367百万円 (△0.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	530.00	-
2024年3月期第3四半期	457.79	-

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期第3四半期	91,381	43,146	47.2	3,289.74
2024年3月期	91,254	38,735	42.4	2,955.88

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 43,146百万円 2024年3月期 38,735百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	-	0.00	-	200.00	-
2025年3月期	-	0.00	-	-	-
2025年3月期（予想）	-	-	-	243.00	243.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「-」と記載しております。

### 3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	75,100	11.2	12,400	6.1	12,100	4.2	9,100	3.5	694.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(注) 詳細は、添付資料P. 8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更に関する注記)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期3Q	13,971,900株	2024年3月期	13,971,900株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	856,482株	2024年3月期	867,367株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期3Q	13,110,410株	2024年3月期3Q	13,217,417株

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当四半期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当四半期の財政状態の概況 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(会計方針の変更に関する注記) .....	8
(四半期連結貸借対照表に関する注記) .....	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....	8
(セグメント情報等の注記) .....	9
(収益認識に関する注記) .....	11

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期の経営成績の概況

#### ①業績全般について

当第3四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、スマートフォン、パソコンの需要低迷が継続する中で、半導体業界においてはI o T、5G、AIなどの需要が引き続き底堅く、ロジック／ファウンドリ向け、メモリ向けなどの設備投資が堅調に推移しました。FPD (Flat Panel Display) 業界においては全般的に設備投資が低調な状況が継続しました。また、流通機器業界においては新紙幣発行に伴う機器更新の需要が高まりました。

このような環境の中、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高は、半導体分野では前工程は減少したものの後工程の先端パッケージ向け装置が好調であり、前年同期に比べ増加、FPD分野では前年同期に比べ微増、流通機器分野の売上増加も寄与し、全体では56,554百万円（前年同期比18.1%増）となりました。利益面では、半導体後工程や流通機器分野の売上増加により営業利益が9,296百万円（前年同期比14.7%増）、経常利益が9,180百万円（前年同期比14.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が6,948百万円（前年同期比14.8%増）となりました。

なお、受注高は、半導体分野では前工程のロジック／ファウンドリ向け装置、後工程の生成AI用GPU用途を含む先端パッケージ向け装置がそれぞれ好調に推移し、真空応用装置の半導体分野向けが低調に推移したものの、前年同期に比べ増加しました。FPD分野は低調に推移し前年同期に比べ減少しました。また、流通機器分野の受注増加も寄与しました。この結果、当第3四半期連結累計期間における受注高は54,541百万円（前年同期比17.1%増）となりました。

#### ②セグメントの業績について

##### (ファインメカトロニクス部門)

売上高は、半導体前工程ではロジック／ファウンドリ向け装置、マスク向け装置が順調に推移したものの、シリコンウェーハ向け装置が前年度受注減少の影響を受け低調となったことから、前年同期に比べ減少しました。FPD前工程は低調で、前年同期に比べ微増となりました。この結果、部門全体では前年同期と同等となり、35,309百万円（前年同期比0.7%減）となりました。

セグメント利益は、半導体前工程での売上減少に加え、販売費及び一般管理費が増加したことなどから、5,629百万円（前年同期比22.7%減）となりました。

なお、受注高は、半導体前工程ではロジック／ファウンドリ向け装置が好調に推移しました。FPD前工程では市況の影響を受け低調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が増加し、33,429百万円（前年同期比16.2%増）となりました。

##### (メカトロニクスシステム部門)

売上高は、半導体後工程では生成AI用GPUの需要増に伴い先端パッケージ向け装置が好調に推移し、前年同期に比べ大幅に増加しました。FPD後工程は低調で、前年同期と同等となりました。真空応用装置は、半導体分野向けが堅調に推移し前年同期に比べ増加しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ大幅な増収となり、15,188百万円（前年同期比71.6%増）となりました。

セグメント利益は、半導体後工程及び真空応用装置の売上増加により大幅な増益となり、3,023百万円（前年同期比195.7%増）となりました。

なお、受注高は、半導体後工程では生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移しました。FPD後工程及び真空応用装置の半導体分野向けでは、市況の影響を受け低調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が増加し、15,732百万円（前年同期比20.0%増）となりました。

##### (流通機器システム部門)

新紙幣発行に伴い、紙幣識別機器の更新のほか、券売機、汎用自販機の売上が好調に推移しました。この結果、売上高は4,702百万円（前年同期比117.7%増）、セグメント利益は1,238百万円（前年同期比424.8%増）となりました。

##### (不動産賃貸部門)

不動産賃貸収入は計画どおり推移し、売上高は1,353百万円（前年同期比1.1%増）、セグメント利益は296百万円（前年同期比2.8%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ127百万円増加し91,381百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が3,505百万円減少した一方で、現金及び預金が789百万円、仕掛品が1,915百万円、建設仮勘定が1,254百万円増加したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ4,283百万円減少し48,235百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,879百万円、電子記録債務が1,468百万円、未払費用が1,301百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ4,410百万円増加し43,146百万円となりました。これは主に、配当金の支払により2,629百万円減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により6,948百万円増加したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年11月7日に公表いたしました通期連結業績予想から変更ありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	27,214	28,003
受取手形、売掛金及び契約資産	※2 35,417	※2 31,912
電子記録債権	※2 877	※2 1,022
商品及び製品	2,321	2,229
仕掛品	5,764	7,679
原材料及び貯蔵品	514	685
未収入金	2,764	2,110
その他	427	589
貸倒引当金	△1,259	△1,028
流動資産合計	74,041	73,204
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	30,890	31,021
減価償却累計額	△21,031	△21,312
建物及び構築物（純額）	9,858	9,708
機械装置及び運搬具	8,705	9,685
減価償却累計額	△6,139	△7,093
機械装置及び運搬具（純額）	2,566	2,591
工具、器具及び備品	1,630	1,774
減価償却累計額	△1,245	△1,351
工具、器具及び備品（純額）	384	422
土地	119	119
リース資産	201	200
減価償却累計額	△94	△113
リース資産（純額）	106	87
建設仮勘定	1,224	2,478
有形固定資産合計	14,261	15,409
無形固定資産		
特許権	418	458
その他	189	216
無形固定資産合計	607	674
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
長期前払費用	32	56
繰延税金資産	2,076	1,808
その他	234	228
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	2,343	2,093
固定資産合計	17,212	18,177
資産合計	91,254	91,381

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※2 13,473	※2 11,594
電子記録債務	※2 4,319	※2 2,851
短期借入金	3,650	6,350
1年内返済予定の長期借入金	3,400	1,400
リース債務	31	22
未払法人税等	1,720	1,223
未払費用	4,808	3,506
前受金	8,358	8,343
役員賞与引当金	168	102
製品保証引当金	159	195
その他	1,521	※2 2,804
流動負債合計	41,611	38,394
固定負債		
長期借入金	1,600	900
リース債務	80	68
退職給付に係る負債	5,710	5,347
役員退職慰労引当金	40	37
修繕引当金	329	341
資産除去債務	67	67
長期預り保証金	3,078	3,078
固定負債合計	10,907	9,840
負債合計	52,518	48,235
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	6,939	6,939
利益剰余金	26,586	30,905
自己株式	△2,354	△2,284
株主資本合計	37,933	42,321
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	671	640
退職給付に係る調整累計額	130	184
その他の包括利益累計額合計	802	825
純資産合計	38,735	43,146
負債純資産合計	91,254	91,381

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上高	47,899	56,554
売上原価	28,752	34,697
売上総利益	19,146	21,856
販売費及び一般管理費	11,042	12,559
営業利益	8,104	9,296
営業外収益		
受取利息	11	50
受取配当金	0	0
為替差益	419	24
協力金収入	16	30
その他	103	42
営業外収益合計	550	147
営業外費用		
支払利息	53	61
固定資産廃棄損	156	117
デリバティブ評価損	303	1
その他	141	82
営業外費用合計	655	263
経常利益	7,999	9,180
税金等調整前四半期純利益	7,999	9,180
法人税、住民税及び事業税	1,321	1,964
法人税等調整額	627	267
法人税等合計	1,948	2,231
四半期純利益	6,050	6,948
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,050	6,948



(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	6,050	6,948
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	198	△31
退職給付に係る調整額	118	54
その他の包括利益合計	316	22
四半期包括利益	6,367	6,971
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,367	6,971

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更に関する注記)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当第3四半期連結累計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第3四半期連結累計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(四半期連結貸借対照表に関する注記)

## 1 保証債務

当社の従業員の住宅資金借入金に対し、債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
従業員	1百万円	1百万円
計	1	1

## ※2 四半期連結会計期間末日満期手形等

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
受取手形	81百万円	104百万円
電子記録債権	45	51
支払手形	42	21
電子記録債務	891	392
流動負債 その他 (設備関係電子記録債務)	—	1,286

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	1,688百万円	1,927百万円

(セグメント情報等の注記)

## 【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	35,551	8,849	2,159	1,338	47,899
セグメント間の内部売上高又は振替高	40	200	—	70	310
計	35,591	9,049	2,159	1,408	48,210
セグメント利益	7,287	1,022	236	288	8,834

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	8,834
全社費用(注)	△771
その他	△63
四半期連結損益計算書の経常利益	7,999

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## II 当第3四半期連結累計期間(自2024年4月1日至2024年12月31日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク システム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	35,309	15,188	4,702	1,353	56,554
セグメント間の内部売上高又は振替高	22	627	—	91	741
計	35,332	15,815	4,702	1,444	57,296
セグメント利益	5,629	3,023	1,238	296	10,188

## 2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	10,188
全社費用(注)	△805
その他	△202
四半期連結損益計算書の経常利益	9,180

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(収益認識に関する注記)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
S P E (半導体)	30,817	6,862	—	—	37,680
F P D (Flat Panel Display)	3,083	997	—	—	4,081
その他	1,650	988	2,159	19	4,817
顧客との契約から生じる収益	35,551	8,849	2,159	19	46,579
その他の収益	—	—	—	1,319	1,319
外部顧客への売上高	35,551	8,849	2,159	1,338	47,899

(注) 「その他」の区分は、自動販売機・自動券売機等を含んでおります。

また、「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入です。

当第3四半期連結累計期間(自2024年4月1日至2024年12月31日)

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
S P E (半導体)	30,226	12,376	—	—	42,602
F P D (Flat Panel Display)	3,382	1,315	—	—	4,697
その他	1,701	1,495	4,702	85	7,985
顧客との契約から生じる収益	35,309	15,188	4,702	85	55,286
その他の収益	—	—	—	1,268	1,268
外部顧客への売上高	35,309	15,188	4,702	1,353	56,554

(注) 「その他」の区分は、自動販売機・自動券売機等を含んでおります。

また、「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入です。